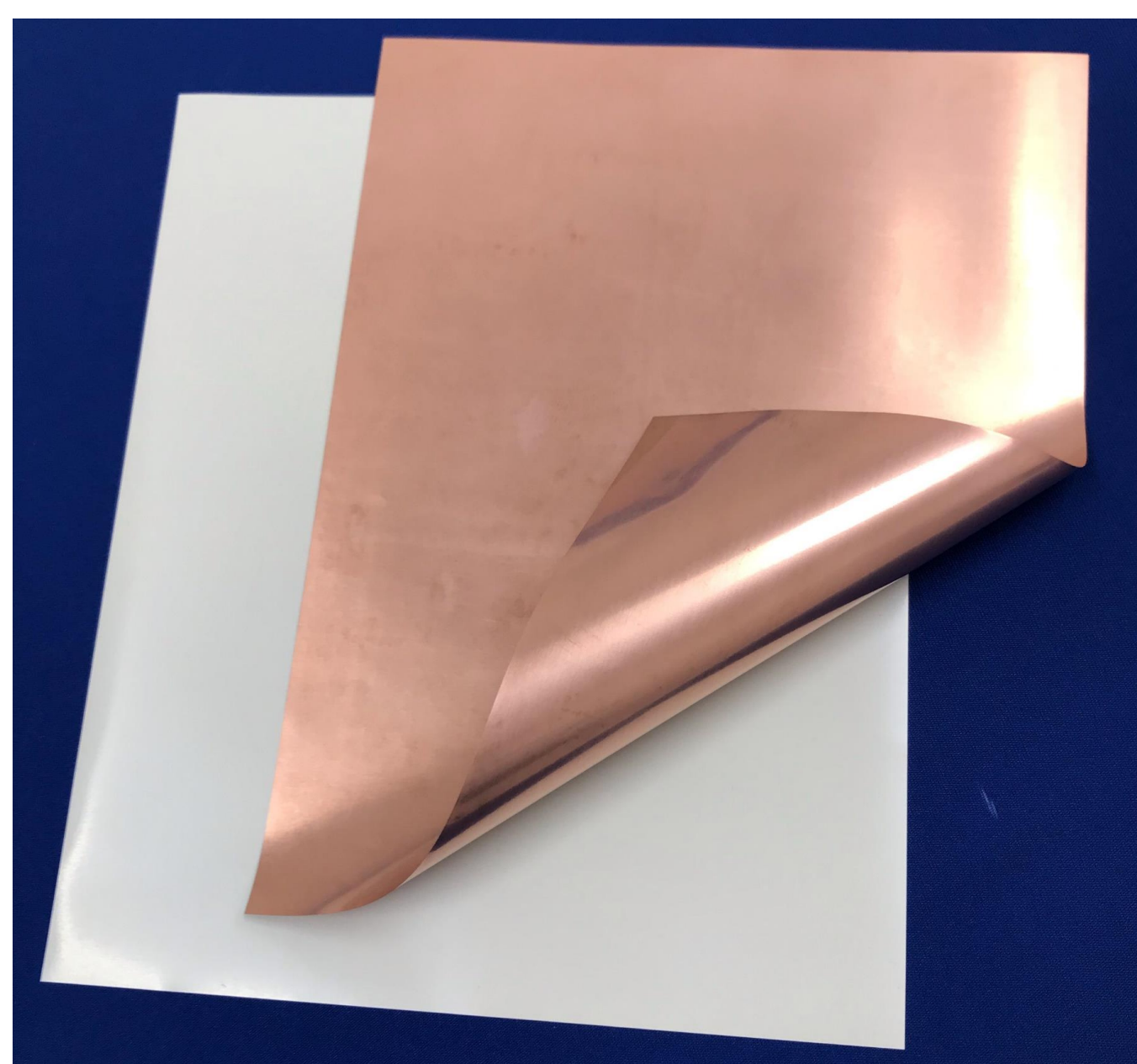
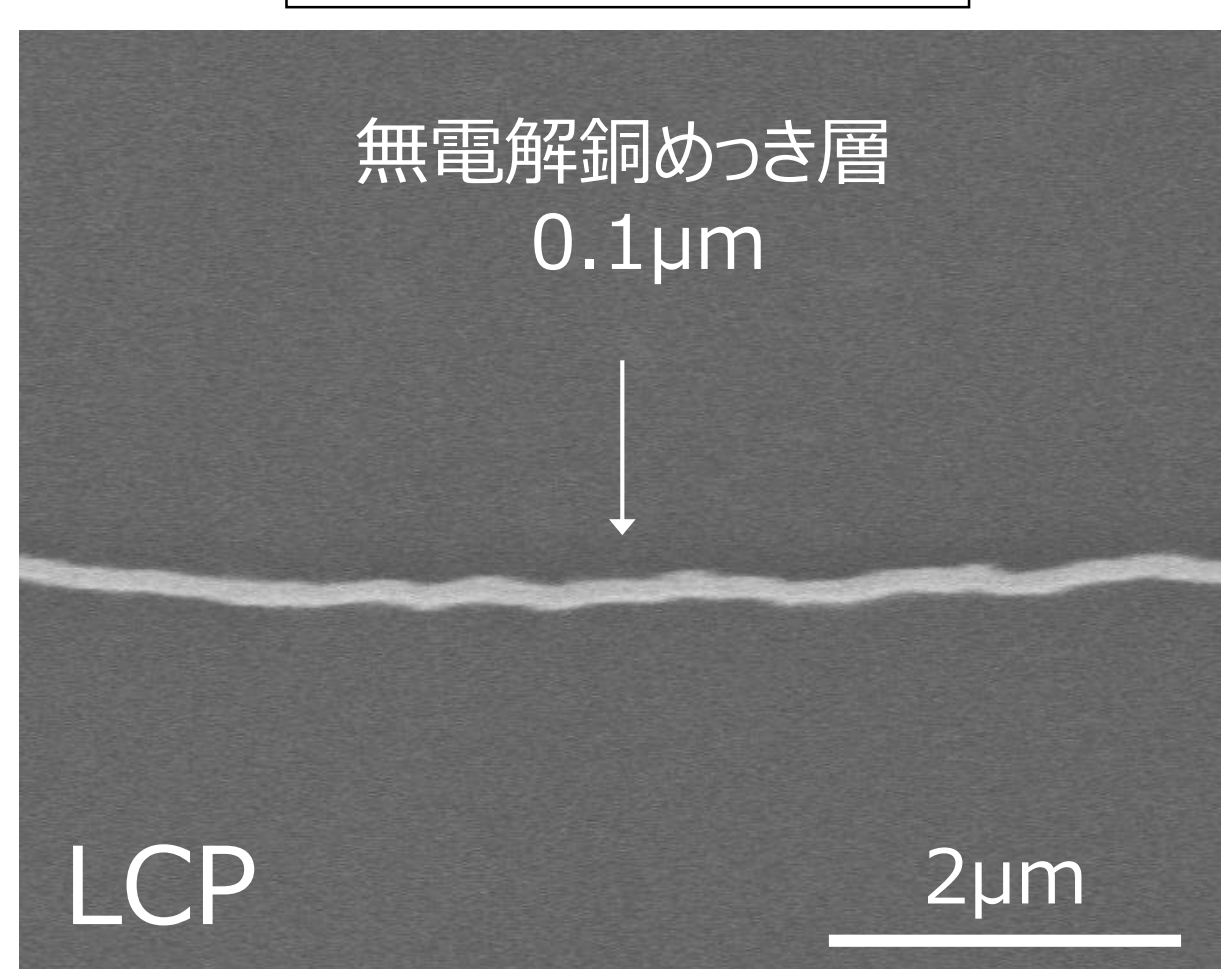


LCPベース フレキシブル銅張積層板 (極薄めっき/微細配線用)

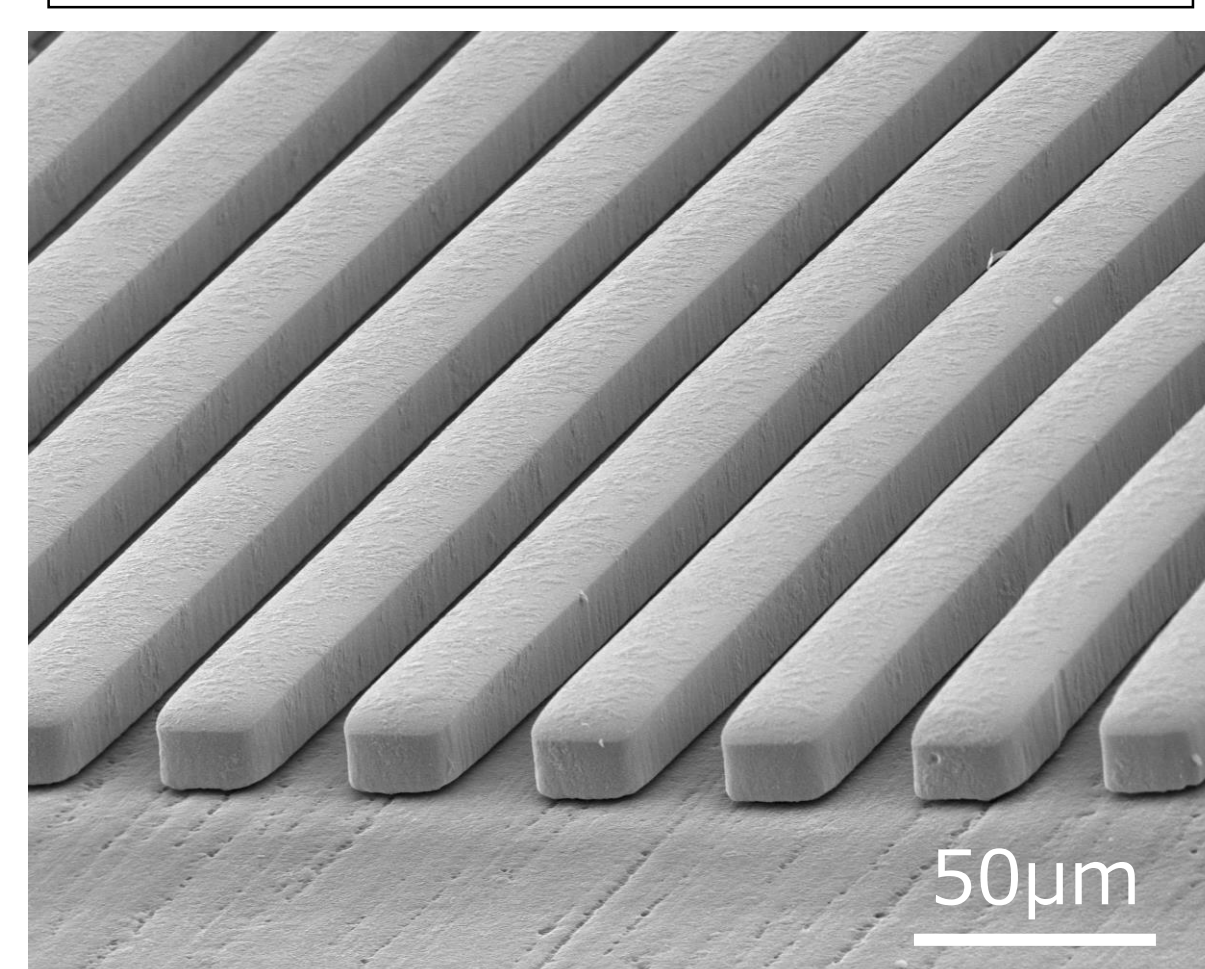
LCP上に0.1~0.3 μm の極薄の銅を無電解めっきにより積層
SAPによる微細配線加工が可能で高周波特性に優れるFCCLです



当社FCCLの断面

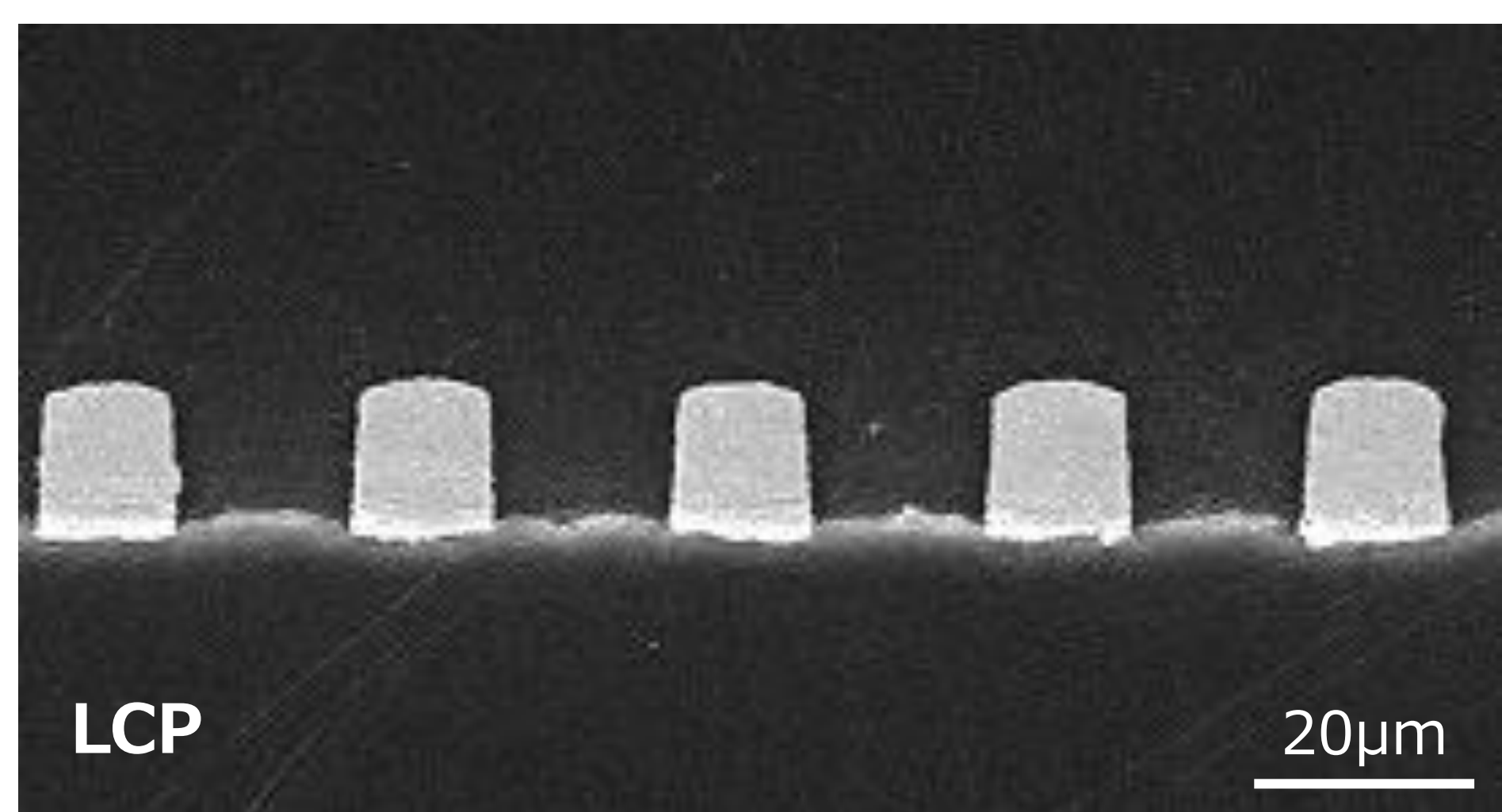


当社FCCLを用いた配線施工例



当社FCCLによる回路の矩形化、微細化

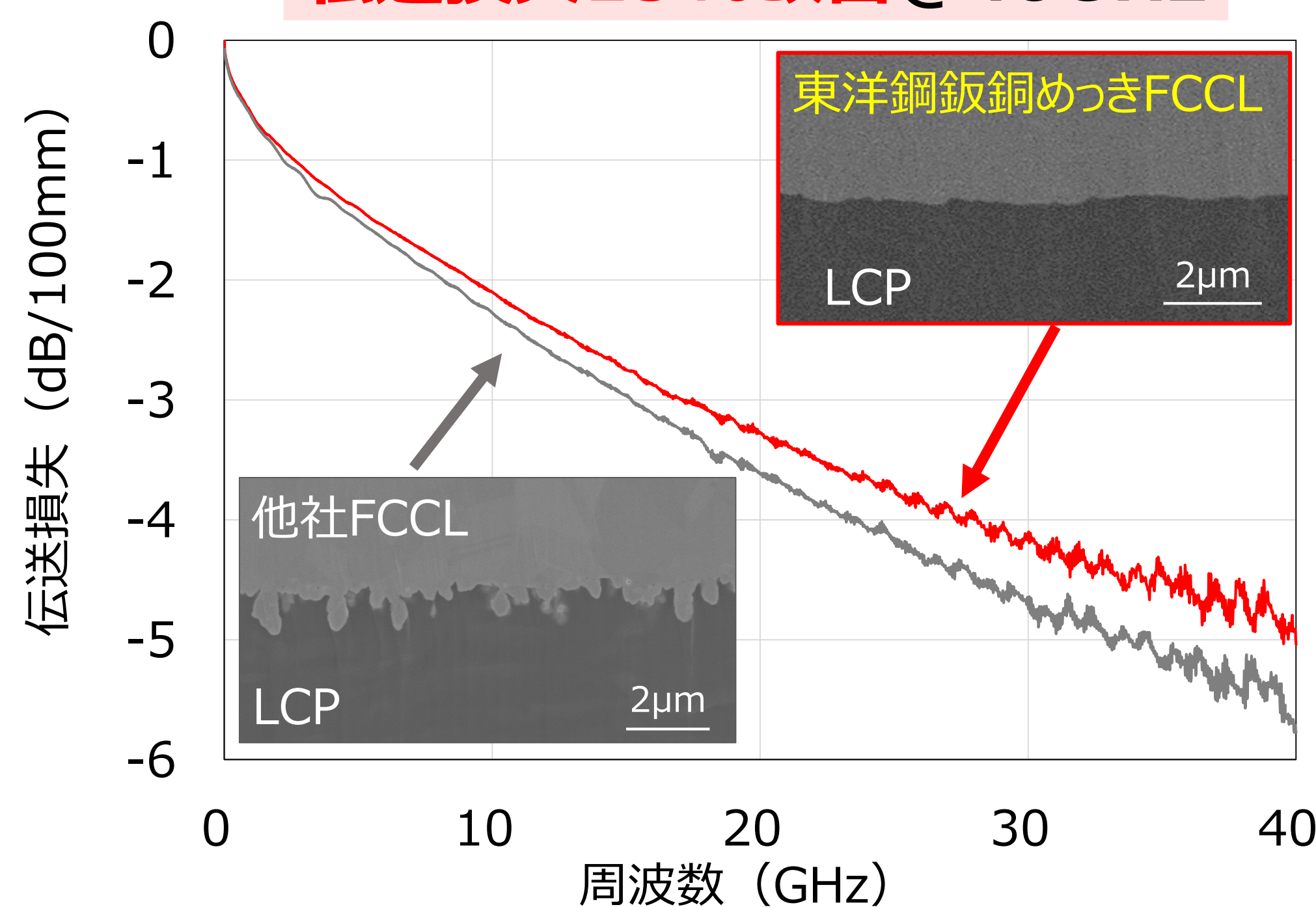
L/S=15/15 μm を形成可能



回路配線の断面像

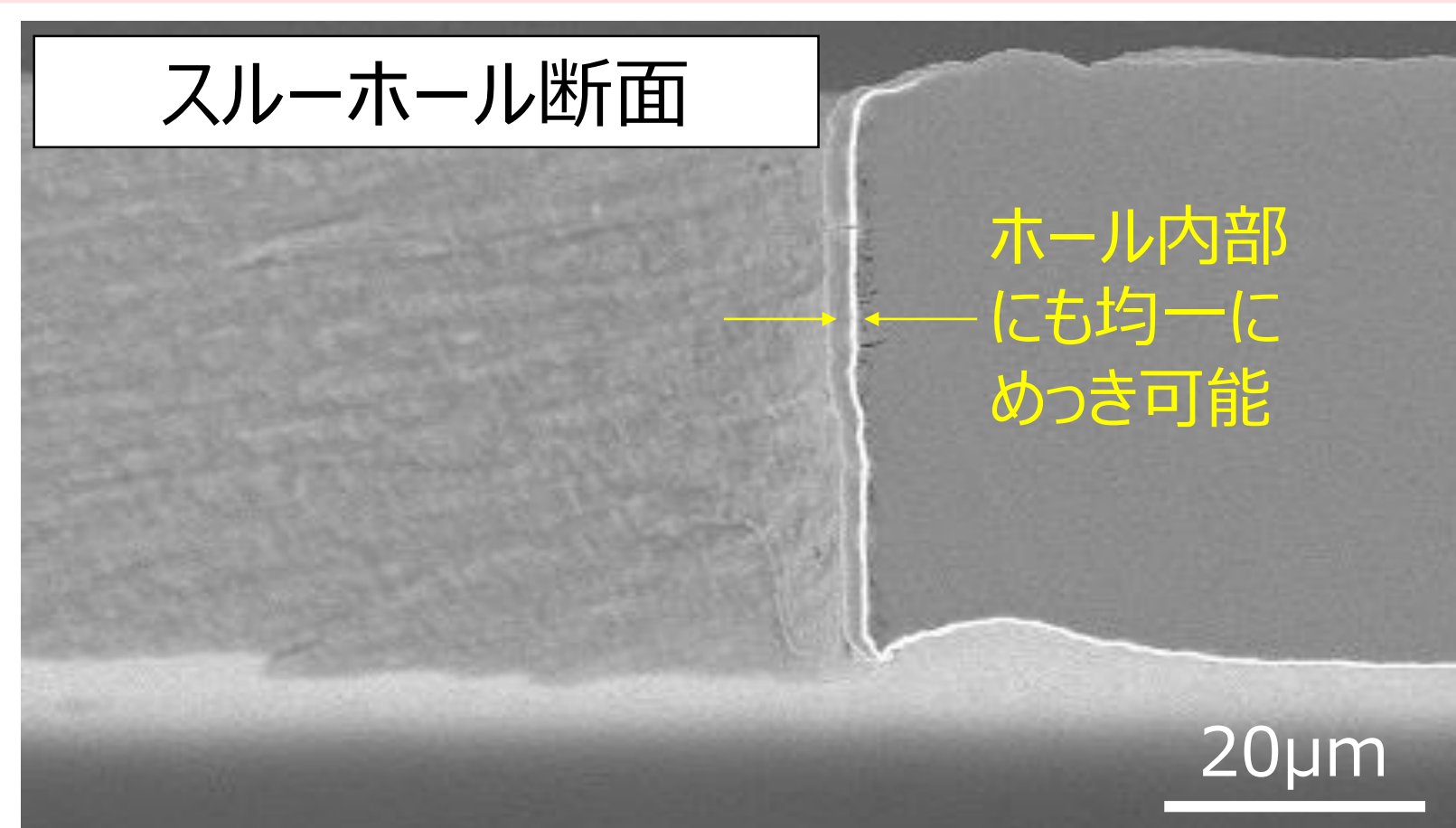
界面平滑化による伝送特性向上

伝送損失15%改善@40GHz



回路形成の省工程化のご提案

スルーホール内壁へも同時にめっき可能



スルーホール断面

ホール内部
にも均一に
めっき可能

開発品の代表的特性

項目	条件	無電解銅めっき FCCL
導体 引き剥がし強さ	18 μm 厚めっき後室温下	0.7 N/mm
	18 μm 厚めっき後 150 $^{\circ}\text{C}$ ×168時間後	0.7 N/mm
誘電正接	開放型共振 ファブリペロー法 28GHz	0.002
比誘電率		3.3
はんだ耐熱	260 $^{\circ}\text{C}$, 5秒	異常なし

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません